## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

and the latest					
Akten	zeichen des Anmelde	rs oder Anwalts WEITER	ES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Intern	ationales Aktenzeiche	Internation 29.10.20	ales Anmeldedatum (TagMonat/Jahr) 004	Prioritälsdatum (Tag/Monat/Jahr) 29.10.2003	
		ikation (IPK) oder nationale K	lassifikation und IPK		
	B7/00				
Anme	elder				
X-F	AB SEMICONDU	CTOR FOUNDRIES AG	et al.		
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Pr üfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Pr üfung beauftragten Beh örde nach Antikel 35 erstellt wurde und dem Anmeider gem äß Artikel 35 bermittelt wird.</li> </ol>					
2.	<ol> <li>Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</li> </ol>				
3.	A Contact linear dem Bericht ANI AGEN beit diese umfassen				
	Auberdem negen own Common Common a.      (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um     Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen undkoder Zeichnungen, die geländer wurden und issem Beinigen Beini				
	zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, der en die Bericht de Zegeen werde. 20 der Verwaltungsvorschriften).				
	□ Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auflässung der Behörde eine Anderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der interentionale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.				
	Datentråg	s Internationale Büro gese er(s) angeben), dor/die ei puterlesbarer Form, wie ir erwaltungsvorschriften).	undt)i> insgesamt (bitte Art und Anzi n Sequenzprotokoll und/oder die da n Zusatzfold betreffend das Sequen	ahl derdes elektronischen zugehörigen Tabellen enthält/enthalten, izprotokoll angegeben (siehe Abschnitt	
4.	Dieser Bericht en	thält Angaben zu folgende	n Punkten:		
	☑ Feld Nr. I	Grundlage des Bescheids	;		
	☐ Feld Nr. II	Priorität			
	☐ Feld Nr. III	Anwendbarkeit	utachtens über Neuheit, erfinderisch	ne Täligkeit und gewerbliche	
İ	☐ Feld Nr. IV	MangeInde Einheitlichkei	der Erfindung	ubala das esfinderinghon Tötinkeit	
	☐ Feld Nr. V	Begründete Feststellung und der gewerblichen An	nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Ne wendbarkeit; Unterlagen und Erklär	ungen zur Stützung dieser Feststellung	
	☐ Feld Nr. VI	Bestimmte angeführte Ur			
	☐ Feld Nr. VII	Bestimmte Mängel der in	ternationalen Anmeldung		
	□ Feld Nr. VIII	Bestimmte Bemerkunger	zur internationalen Anmeldung		
Date	um der Einreichung d	es Antrags	Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts	
02.	.07.2005		04.01.2006		
Nar	uftragten Behörde	der mit der internationalen Pr	üfung Bevollmächtigter Bedi	ensteter yes	
-	Europäisc	nes Patentamt fünchen	Götz, A	( <b>((</b> (	
_	O))) Tel. +49 8	9 2399 - 0 Tx: 523656 epmu ( 19 2399 - 4465	Tel. +49 89 2399-249	8	

		aluto			
_	Feld Nr. I Grundlage des Berid	cnts			
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	bei der es sich um die Spract	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, he der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:			
	☐ internationale Recherche ☐ Veröffentlichung der internationale vorläufige F	(nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) nationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ๆนันทฤ (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)			
2.	Hinschtlich der <b>Bestandteile*</b> der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Auflorderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als *ursprünglich eingereicht* und sind ihm nicht beige fügt):				
	Beschreibung, Selten				
	1-7	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ansprüche, Nr.	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	1-20	in der displatiglich eingereinnen Laufag			
	Zeichnungen, Blätter				
	1/2-2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	☐ einem Sequenzprotokoll und Sequenzprotokoll	dlöder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das			
3.	<ol> <li>Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:</li> </ol>				
	<ul> <li>☐ Beschreibung: Seite</li> <li>☐ Ansprüche: Nr.</li> </ul>				
	□ Zeichnungen: Blatt/Abb.				
		otokoli genorende Tabelleri (genade Angaberi).			
4	□ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).				
	☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb. ☐ Sequenzprotokoll (gena) ☐ etwaige zum Sequenzpi	iue Angaben): rotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* Wenn Punkt 4 zutriff "ersetzt" versehen werd	t, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung en.			

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung.

 Feststellung Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-20

Nein: Ansprüche Frfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche

Ja: Ansprüche 1-20 Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-20

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US 2002/086456 A1 (CUNNINGHAM SHAWN JAY ET AL) 4. Juli 2002

D2: US 6 020 646 A (BOYLE ET AL) 1. Februar 2000

D3: EP 0 886 144 A (STMICROELECTRONICS S.R.L) 23. Dezember 1998

D4: US 5 164 328 A (DUNN ET AL) 17. November 1992 D5: US 5 955 771 A (KURTZ ET AL) 21. September 1999

D6: US 6 517 399 B1 (ITO NOBUHIRO ET AL) 11. Februar 2003

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 2 Das Dokument D1, wird als n\u00e4chstliegender Stand der Technik angesehen. Es offenbart ein Verfahren zum festen Verbinden von prozessierten Halbleiterscheiben (siehe D1, Absatz [0055] und die Abbildungen 1-3), wobei in einem Arbeitsgang eines mechanisch festen Verbindens sowohl elektrisch isolierende Verbindungen als auch elektrisch leitende Verbindungen zwischen den Halbleiterscheiben hergestellt werden; mit zumindest folgenden spezifischen Hauptarbeitsg\u00e4ngen.
  - geometrisches Ausrichten der zu verbindenden Scheiben;
  - Zusammenfügen der Scheiben.

In D1 wird vorgeschlagen die Scheiben mit Glaslot zu bonden (siehe D1, Absatz 10055l).

Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem aus D1 bekannten Verfahren unter anderem dadurch, daß in Anspruch 1 definiert ist, daß auf die Scheiben elektrisch leitende Glaspaste aufgebracht wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Material für die leitende Verbindung zu finden, das mit den gleichen Mitteln und in den selben Arbeitsschritten prozessiert werden kann. Die Aufgabe wird mit Verwendung der elektrisch leitenden Glaspaste gelöst. (BEIBLATT)

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Die Dokumente D2-D4 offenbaren keine elektrisch leitenden Glaspaste und führen daher nicht weiter. Die Dokumente D5 und D6 offenbaren zwar elektrisch leitende und nicht-leitende Glaspasten die beim Verbinden gleichzeitig prozessiert werden. Bei Dokument D5 wird der Glasdeckel eines Chips mit einem Glas-Sockel einer Verkapselung verbunden (siehe D5, Abbildung 7C und dazugehörige Beschreibung). Im Falle von Dokument D6 werden zwei Scheiben für ein Display miteinander verbunden (siehe D6, Abbildung 11 und Spalte 28, Zeilen 11-24). Bei keinem von D5 und D6 wird ein Verfahren zum Verbinden von Halbleiterscheiben beschrieben. Es scheint daher nicht naheliegend Verfahrensschritte aus D5 oder D6 mit dem aus D1 bekannten Verfahren zu kombinieren.

3 Die selben Überlegungen treffen auch auf die unabhängigen Ansprüche 10, 11 und 20 zu.

# Zu Punkt VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 4 Die Ansprüche 1, 11 und 20 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird bzw. nur durch die für die Merkmale dieses Gegenstandes verwendete Terminologie. Aus diesem Grund sind die Ansprüche nicht knapp gefaßt und erfüllen sie nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.
- 5 Die Merkmale der Vorrichtung in dem Vorrichtungsanspruch 10 werden durch ein Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung und nicht anhand der strukturellen Merkmale der Vorrichtung definiert ("product-by-process claim"). Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor.